

Автоматическая установка монтажа шариков припоя и лазерной пайки **SB² COMPACT**

SB²-Compact – это новая модель в серии SB2, являющейся лидером в отрасли оборудования для лазерной пайки. Благодаря сочетанию преимуществ технологии SB² с ультракомпактной конструкцией, возможностью гибкой комплектации и низкой стоимостью владения оборудованием, установка SB²-Compact является идеальным решением в случае ограниченного бюджета.

Её использование может быть первым шагом для внедрения и постепенного наращивания степени автоматизации процесса последовательного монтажа и лазерной пайки шариков припоя для сборки разного рода изделий микроэлектроники – в особенности, модулей камер, датчиков и других оптических устройств.

Установка SB²-Compact легко интегрируется в любую производственную линию, поскольку её можно оборудовать загрузочно-разгрузочными системами разного типа – такими как выдвижная односекционная загрузочно-разгрузочная система, встроенный конвейер или система автоматической загрузки кассет. Конструкция установки в соответствии с принципом «подключи и работай» позволяет выполнять модернизацию загрузочно-разгрузочной системы. Установка SB²-Compact способна работать с шариками припоя диаметром от 150 до 1000 мкм. Скорость монтажа 6-8 шариков в секунду. Установка доступна к заказу в различных цветовых решениях по выбору заказчика.



Применение: сборка оптических приборов и фото/видеокамер.

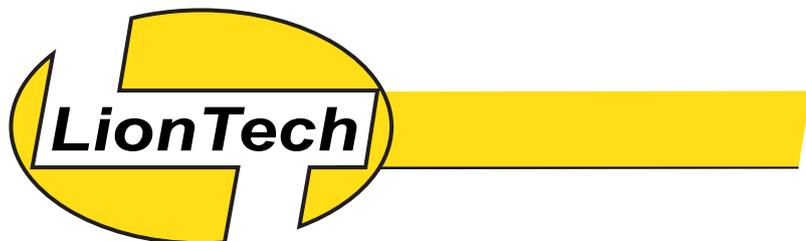
Основные возможности:

- Бесконтактный монтаж шариков припоя
- Материалы припоя – SnAgCu, SnAg, SnPb, AuSn, InSn, SnBi
- Бесфлюсовая пайка методом лазерного оплавления
- Диаметр шариков припоя от 150 мкм до 1000 мкм

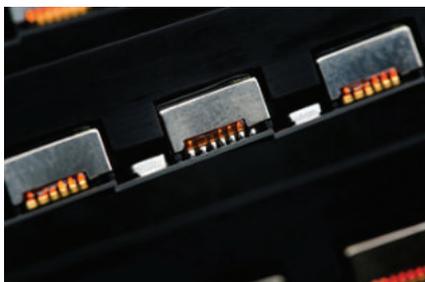
Возможные применения:

- Сборка фото/видеокамер
- Сборка 3D-компонентов и устройств
- Боллинг BGA/CSP компонентов
- Пайка выводов, контактов, перемычек





**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**



Звонок по России бесплатный:

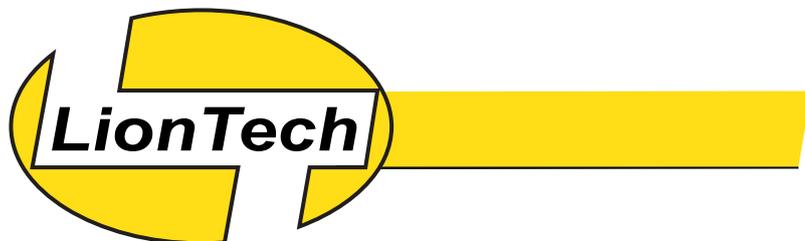
8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru

*Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники*



**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Технические характеристики

Параметры	SB ² -Compact
Габариты	1100 x 704 x 1893 мм
Рабочая зона	200 x 200 мм
Скорость монтажа шариков	6-8 шариков в секунду
Диаметр шариков	≥ 150 мкм
Точность монтажа	± 5 мкм, 1 σ
Рабочая станция	Выдвижная секция / Встроенный конвейер
Автоматизация	2D пайка с автоповоротом оснастки
Лазерная ручная центровка	Есть
Лазерная автоматическая центровка	Опция
Распознавание образов	Есть
2D пайка	Да
3D пайка	Да
Ремонт	Нет
Виды изделий	Корпуса BGA, CSP, фото/видеокамеры

ООО «ЛионТех-С»
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru

*Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники*